

# 半導体リレーモジュール

量産品  
2025年搭載予定

リレーの半導体化による省電力化と軽量化、および  
オリジナル電線保護ロジックによるFUSEレス化の実現と搭載の自由度向上

## 背景・課題

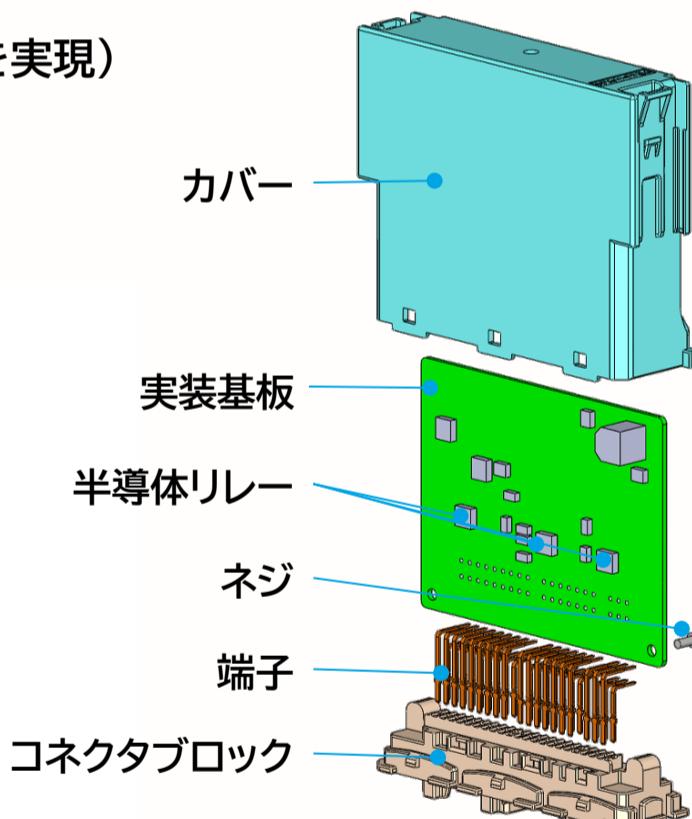
搭載スペースの縮小により、電源BOXの小型化が求められている

## 課題への解決・特徴

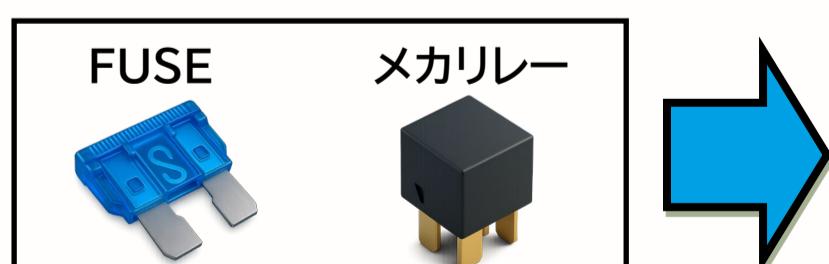
- 1 半導体リレー採用による電源BOXの小型、軽量化
- 2 オリジナル電線保護ロジックによるFUSEレスの実現
- 3 FUSEレスシステムによる、搭載レイアウト性向上  
(FUSE交換不要になり、メンテナンスフリー化を実現)

### 主要性能、仕様・構造

電源電圧	8V ~ 16V
使用温度	-40°C ~ +85°C
入力	4回路
出力	IPD駆動 8回路
	外部RLY駆動 6回路
通信回路	1CH (CAN)
その他	FUSEレス ECE R48(PWM出力)対応

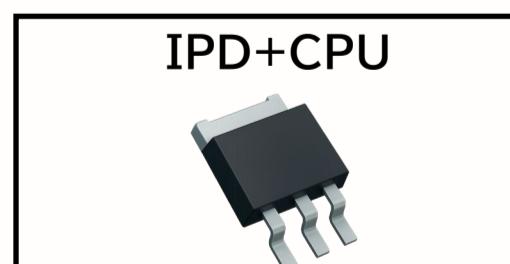


### FUSE + メカリレー



消費電力:0.2W + 1.25W = 1.45[W]  
重量:0.4g + 14.0g = 14.4[g]

### 半導体ヒューズ (IPD+CPU)



:0.25[W]  
: 1.0[g]